

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2024-006

## 中颖电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 340,115,926 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	中颖电子	股票代码	300327
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘一德	徐洁敏	
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号	上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号	
传真	021-61219989	021-61219989	
电话	021-61219988	021-61219988-1688	
电子信箱	dpsino168@126.com	jxsino327@126.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司主要业务及产品

公司采用业界惯见的无晶圆厂模式，即无生产线的 IC 设计公司，仅从事 IC 设计及销售业务。主要产品区分为工业控制芯片和消费电子芯片。工业控制芯片主要用于智能家电、锂电池管理、变频电机控制及智能电表。消费电子芯片主要用于 AMOLED 屏幕显示驱动、键盘及鼠标控制和无线血压计及血糖仪。

类别	细分行业	下游应用领域及应用示例	主要同业公司列举
工业控制芯片	智能家电控制	智能家电	瑞萨、英飞凌、中微半导体、ABOV
	变频电机控制	电动自行车、变频电机	瑞萨、意法半导体
	锂电池管理	手机、笔电、动力锂电池	德州仪器、艾普凌科、瑞萨
消费电子	电脑周边及物联网	键盘、鼠标、无线血压计及血糖仪	意法半导体、瑞萨、Nordic
	AMOLED 显示驱动	手机、智能穿戴	联咏、瑞鼎、云英谷科技

### （二）行业发展状况

集成电路产业是现代信息科技技术发展的重要载体，是国家大力支持的战略性、先导性产业。芯片设计强调以创新为核心，以高科技创新实现下游应用领域的高效能及高质量，响应了国家策略方向大力发展的新质生产力。据海关总署公布的 2023 年进出口主要商品数据，2023 年中国进口集成电路 3,494 亿美元，高于原油的 3,375 亿美元，显示进口替代的市场空间和机遇仍然巨大。

根据中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授于 2023 年 11 月公开的报告指出，截至其报告时国内涉及的集成电路设计企业数量为 3,451 家，预计 2023 年国内芯片设计产业的销售额为 5,773 亿元（约合 825 亿美元），同比增长 8%。预计 2023 年将将有 625 家企业销售额超过 1 亿元人民币。整体的芯片设计企业数量多而规模偏小。根据 2023 年上半年已经上市的 108 家设计企业的半年报数据，上市企业的销售收入总和为 1,359 亿元人民币，占全行业的比重为 23.5%，盈利企业 66 家，亏损企业 42 家。当前中国集成电路设计业正在向高端迈进，但主流还处在中低端，高端芯片的研发只属于少数有实力的企业，国内芯片设计企业的发展质量仍需改善。

根据美国半导体行业协会(SIA)公布的数据，2023 年全球半导体销售额总计 5,268 亿美元，与 2022 年 5,741 亿美元的总额相比下降了 8.2%。但 2023 年下半年销售额有所回升。第四季度的 1,460 亿美元销售额比 2022 年第四季度的总销售额高出 11.6%，比 2023 年第三季度的总销售额高出 8.4%。SIA 也预测随着去年下半年半导体市场回暖，2024 年这一数据有望实现两位数反弹。据世界半导体贸易统计组织(WSTS)于 2023 年 11 月的预测，2023 年全球半导体市场预计将有 9.4%的萎缩，而随后将出现强劲复苏，预估 2024 年将增长 13.1%。

2023 年是全球电子及半导体产业相当低谷的一年；市场终端忙着消化行业周期盛极反转前超屯的库存，多数芯片设计公司的经营绩效也被积压库存的高成本压抑着。2024 年行业普遍预期市场需求良性恢复，芯片设计公司的成本结构逐步改善，高库存情况得到缓解。从历史逻辑看，半导体行业周期一般为 3-5 年，这轮的行业周期顶峰是 2022 年上旬，从 2022 年下旬起开始下行，2024 年将见底回升符合历史逻辑判断。

### （三）公司的行业地位

公司自 2002 年起专注开发自有品牌的产品，是国内较早从事芯片设计的公司之一，在部分细分领域取得了头部的市场地位。公司目前的主要产品线为工规级 MCU、锂电池管理芯片及 AMOLED 显示驱动芯片。经过多年发展经营，公司的工规级 MCU 已经在家电领域被国产品牌客户广泛采用，市占率处于国产芯片的领先群。公司坚持高质量发展、深耕技术，工规级 MCU 产品已经站上国际竞争平台，现正积极开拓海外家电品牌市场，已经取得部分订单，应用面上也在工业及机器人等领域有所延伸。锂电池管理芯片涉及终端应用的安全性，产品的质量及可靠性要求极高，公司的锂电池管理芯片已经被国内一线安卓手机品牌大厂广泛采用，与其他国产芯片厂家相比，处于赛道的领先地位，主要的竞争对手为国际大厂 TI；在电动自行车领域，公司的锂电池管理芯片也处于国产芯片市场的领先地位。公司的 AMOLED 显示驱动芯片目前主要经营二级市场，品牌市场目前主要为韩系及台系厂商所占据，公司已经开发出并规划推出多款新品针对品牌市场规格的 AMOLED 显示驱动芯片，将积极推动品牌客户验证及新品的量产导入。

### （四）主要产品集成电路产品所属细分领域市场、技术发展情况

公司主要产品区分为工业控制芯片和消费电子芯片。工业控制芯片主要用于智能家电、锂电池管理、变频电机控制及智能电表。消费电子芯片主要用于 AMOLED 屏幕显示驱动、键盘及鼠标控制和无线血压计及血糖仪。报告期内，工业控制芯片的销售占比为 78%，消费电子芯片占比为 22%。

#### （1）工控 MCU

公司的工规级 MCU 是国内家电品牌大厂进口替代的主要选择，客户对于国产替代存在需求，但是对于产品质量、可靠度要求的高标准与进口并无二致。在白色智能家电 MCU 领域，相较于欧、日厂家，公司产品的性价比及在地化服务有相对优势，挑战在于客户基于已有系统规格提出的替换要求，对芯片的兼容性的要求极高。从市占率上来说，瑞萨在白色家电 MCU 市场一家独大，中颖，英飞凌处于较强的局面，其余的国内外竞争者市占率较低。公司所占市场份额仍低于海外厂家，有较充足的市场空间可供公司进一步实现增长。生活电器市场受到全球经济下滑的影响，整个行业相比去年出货量有所下降，有较多的国产芯片公司也进入了这个市场，由于半导体行业也处于下行周期中，生活电器 MCU 削价竞争情况较为普遍。公司在生活电器 MCU 市场的市占率高，所以销售额也受到了相应的影响。整个家电行业加速向智能化、节能、高端化发展，未来在智能家电市场可望产生更多的迭代消费需求。公司积极布局 32 位 MCU，并推出 WiFi/BLE Combo MCU 新品，符合行业发展趋势。家电主控 MCU 生产制程升级换代的频次不大，主流制程在 8 英寸晶圆，0.11um 制程，发展向 12 英寸晶圆，55nm/40nm 制程。

#### （2）锂电池管理芯片

公司的锂电池管理芯片主要用在手机、笔电、穿戴、电动自行车、扫地机及电动工具等诸多应用，目前该领域美、日厂商仍处于相对垄断地位。随着公司经历多年的技术积累及发展，性能完全满足应用端要求。锂电池管理芯片的核心技术主要表现在系统结构定义能力，算力，容量算法精确度，协议的兼容性等方面，IC 设计制程由早期的 0.25um/0.11um 工艺逐步向 90nm/55nm 精进。对于高串数的锂电池保护产品，核心技术主要集中在 SOC 设计，高压制程的应用成熟度，技术参数的高精度/一致性，方案需满足多种国际安全标准等方面，IC 设计制程由早期的 0.35um/0.25um 工艺逐步向 0.15um/0.11um/90nm 精进，制程耐压由 20V 提高到 80/120V 甚至更高。

#### （3）AMOLED 显示驱动芯片

随着显示屏生产技术精进，国产 AMOLED 屏的生产进入发展期，在主流的中小尺寸手机，穿戴...等应用，已大幅取代韩国独大的地位。随着国内多座 6 代线屏厂落地量产，产品的应用范围也扩展到了 Pad，笔电，车载...等中尺寸的应用。受益于国家政策对 AMOLED 产业的支持，AMOLED 面板产能的扩大以及更多元的产品应用方向，对公司 AMOLED 显屏驱动芯片的研发及生产经营产生正向积极的作用。报告期

内，公司产品线也从手机屏显示驱动芯片二级市场，扩展到国内、外知名品牌穿戴显示驱动芯片，为后续手机显示屏品牌产品的市场推广，奠下更好的合作基础。公司 AMOLED 显示驱动芯片的核心技术在于针对 AMOLED 屏处理的各种视效算法，如 Demura、IR Drop、影像压缩算法…等。与同行业竞争公司比较，公司以研发团队本土化、供应链内制化及关键技术自有化为核心策略，并有就近服务客户，快速反应的优势。公司的劣势则在于与韩系，台系同类的竞争公司相比，在品牌的耕耘合作属于后进厂商，在知名度及合作深度，尚待透过不断推出新产品及加深品牌合作提升。AMOLED 驱动芯片产品所用的半导体制程集中在 55nm/40nm/28nm 的成熟制程。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,183,027,380.12	1,977,670,056.23	10.38%	1,705,303,266.50
归属于上市公司股东的净资产	1,669,591,688.96	1,480,142,555.07	12.80%	1,313,100,092.30
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,300,231,731.10	1,601,894,105.25	-18.83%	1,493,907,714.17
归属于上市公司股东的净利润	186,306,896.48	322,999,516.38	-42.32%	370,653,382.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,721,033.38	345,779,026.48	-70.00%	361,084,581.08
经营活动产生的现金流量净额	-29,700,624.90	3,501,365.76	-948.26%	3,305,230.26
基本每股收益（元/股）	0.5471	0.9521	-42.54%	1.0914
稀释每股收益（元/股）	0.5471	0.9521	-42.54%	1.0914
加权平均净资产收益率	11.66%	22.99%	-11.33%	30.32%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,962,361.45	339,739,630.97	294,008,902.36	377,520,836.32
归属于上市公司股东的净利润	34,183,949.98	51,437,585.21	13,940,960.12	86,744,401.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,845,421.81	43,245,815.81	13,975,317.53	25,654,478.23
经营活动产生的现金流量净额	-51,208,174.56	5,367,559.96	464,677.18	15,675,312.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期	43,073	年度报告披	42,475	报告期末表	0	年度报告披露日	0	持有特别表	0
-----	--------	-------	--------	-------	---	---------	---	-------	---

末普通股 股东 总数	露日前一个 月末普通股 股东总数	表决权恢复的 优先股股东 总数	前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	表决权股份的 股东总数 (如有)		
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威朗国际集团有限公司	境外法人	18.45%	63,110,176.00	0.00	不适用	0.00
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	4.90%	16,767,396.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.88%	16,688,071.00	0.00	不适用	0.00
西藏信托有限公司—西藏信托—华芯晨枫一号股权投资集合资金信托计划	其他	3.47%	11,863,059.00	0.00	不适用	0.00
诚威国际投资有限公司	境外法人	2.39%	8,171,210.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.59%	5,425,388.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.14%	3,915,326.00	0.00	不适用	0.00
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.00%	3,431,521.00	0.00	不适用	0.00
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.00%	3,409,432.00	0.00	不适用	0.00
广运投资有限公司	境外法人	0.86%	2,937,728.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全 称)	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合 计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,834,226	1.12%	421,100	0.12%	5,425,388	1.59%	377,900	0.11%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股份且尚未 归还数量		期末股东普通账户、信用账户 持股及转融通出借股份且尚未 归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	新增	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

全国社保基金四零六组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：鉴于“招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金”、“全国社保基金四零六组合”、“中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金”未在中国登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

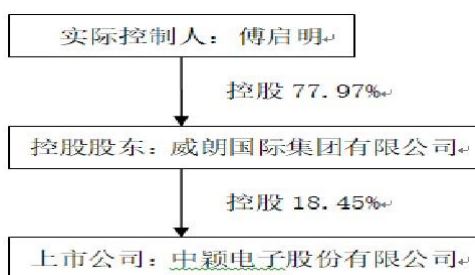
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

公司是芯片设计公司，采用无晶圆厂 (Fabless) 轻资产经营模式，主要从事芯片的设计研发及销售。报告期内，公司营业收入 13 亿元，同比下滑 18.8%；归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比下滑 42.3%；其中非经常性收益 0.83 亿元，主要是收到政府补助款及供货商赔款。报告期内，销售下滑的主因系产品售价大幅下滑所致，公司总销售的芯片数量同比仍有 13.8% 的增长。因产品售价已大幅下滑但是采购成本仍居高不下，毛利率降至 35.62%，同比急遽降低了 10.15%；公司保持研发投入力度，研发费用 3.18 亿元，占公司收入比重为 24.5%。

公司的主要产品线为工规级的微控制芯片及 AMOLED 显示驱动芯片。报告期内，产品市场价格竞争激烈，对公司的销售额产生较大的冲击，AMOLED 显示驱动芯片的销售额下滑逾 3 成，其他产品线的下滑幅度则相对较小，客户由于库存水位较高，上半年订单较少，下半年逐步出现回暖，海外的需求订单也自第四季开始出现恢复。

报告期内，公司积极推进海外客户的开拓，开始收到欧洲及日本客户工规级 MCU 的订单，也推出首颗车规级 MCU，并实现了小量的销售；首颗 WiFi/BLE Combo MCU 完成开发，并将于 2024 年进行推广；完成首颗品牌手机规格的 AMOLED 显示驱动芯片开发；变频大家电 IC 出货量年销近千万颗。

公司发展策略着重长期可持续的发展策略，在产品线规划布局上，重视短、中、长期交替互相补充的产品线布局，重视技术积累。

公司发展战略：

- 1、把握国产替代机遇，进一步扩大国内市场占有率；
- 2、加速推进海外市场拓展；
- 3、集中专注服务行业领先客户，以高质量、差异化产品，高筑竞争者进入障碍；
- 4、与上游供应链紧密合作，科学规划产能布局；
- 5、持续加大研发投入，深耕技术，招募更多高端研发人才，长期培育各产品线往智能化及新能源汽车电子方向发展；
- 6、不间断完善公司治理，培养各阶层专业经理人梯队；
- 7、透过半导体产业投资，寻找合作或加速发展机会。

展望 2024 年，半导体行业周期历经 2023 年的触底后，预期将逐步进入恢复周期。对公司而言，芯片的售价已经调整到本轮上涨周期前的售价，价格向下动能趋减；晶圆代工成本端则还相对偏高，有充足的下降空间，且随着更多的产能供给释放，预期成熟制程晶圆代工价格向下的压力增大。公司将会积极与晶圆代工伙伴争取一定程度合理的价格支持，维持公司的市场竞争力。2023 年公司的存货水平极高，给公司增添了经营风险及现金流压力。公司已经积极进行了供应链的管理，预期存货水平在 2024 年将可有效的下降。AMOLED 显示驱动芯片，今年规划进入品牌市场供应链，实现突破。

公司的智能家电 MCU 进军海外品牌客户已经实现了由 0 到 1 的进展，未来将积极推进。公司计划开展国际通路建设，具体将建立海外技术服务及业务团队；整合公司在 MCU、马达变频驱动及锂电池管理芯片积累的技术切入汽车电子市场，打造质量管控能力至国际级车用 MCU 大厂的相当水平；提升公司在智能家居领域布局的深度及广度。

公司以立足本土、定位进口替代、打造中国芯，提供客户高质量产品及服务为始。公司将保持战略定力，在管理上更加完善公司治理、培育建设管理梯队；重视研发：不断持续加大研发投入、提高研发效能、强化质量管控能力、达成研发团队质与量的提升；市场策略：聚焦服务大客户、高筑竞争者进入门槛、打造公司品牌口碑及形象。长期发展战略的目标是不断提升公司的核心竞争力,要实现进军国际,打造公司成为具有全球竞争力的国际级芯片设计公司。